

### Allgemeines

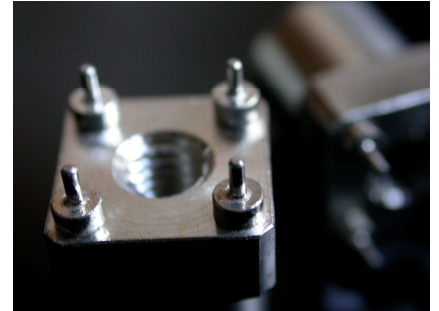
Grundsätzlich ist die **PowerClamp**-Serie für die **SOFTPRESS** Technologie konzipiert.

Es ist jedoch für die B-, N-, und L-Serien auch eine Lötversion lieferbar.

Die Verwendung der Lötversion ist jedoch nur für einseitig kaschierte Leiterplatten sinnvoll, weil in diesem Fall die Bohrungen nicht metallisiert sind und daher die Standart-PressFit-Version nicht eingesetzt werden kann.

Die Lötversion ist durch ein „S“ an der letzten Stelle der Typenbezeichnung gekennzeichnet. (z.B. N1306MS).

Durch die Anbringung eines Passringes entspricht der Bohrplan dem der PressFit-Version. Dies bedeutet, dass man jederzeit, ohne Änderung des LayOuts oder Bohrplans von der Löt- zur PressFit-Version und umgekehrt wechseln kann.

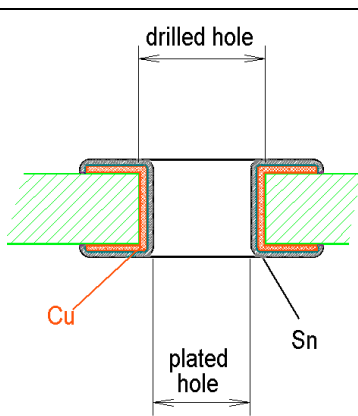
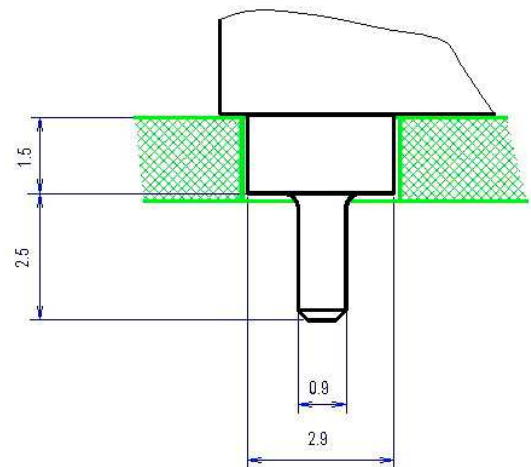


### Technische Daten

#### Wichtig:

Der in den der **PowerClamp**-Datenblättern angegebene Maximalstrom ist für die Lötversion nicht gültig, da dieser sehr von der Qualität der Lötstelle abhängig ist!

Leiterplattendicke	Lötbare Pinlänge
1,5 mm	2,5 mm
1,6 mm	2,4 mm
2,0 mm	1,6 mm
2,4 mm	1,2 mm
3,2 mm	0,8 mm



#### Empfohlene Leiterplatten Konfiguration

Leiterplattendicke: 1.5 – 3.2 mm

Enddurchmesser der Bohrung (plated hole) =  $3.0^{+0.1/-0.05}$  mm

Bohrdurchmesser (drilled hole) = Enddurchmesser + 0.15 mm

Cu Metallisierung = mind. 15  $\mu$ m

Sn Metallisierung = mind 5  $\mu$ m